

<u>SAC2002</u>	<u>Descripción de los Productos</u>	<u>Tipo Base</u>	<u>Tipo Consolidado</u>	<u>Implementación</u>	<u>Instrum. en el que se establece la concesión actual</u>	<u>Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT</u>	<u>Demás Cargas y Derechos</u>	<u>Apénd. A - Apénd. A - Apénd. B</u> <u>Sección 1</u> <u>Sección 2</u> <u>B</u>
8466.91	-- Para máquinas de la partida n° 84.64							
ex 8466.91.00	-- Partes de las máquinas para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos o los discos (obleas) en microplaquitas.	35	0	2010	UR/94	HN/94	0	129
ex 8466.91.00	-- Partes de las máquinas de fragmentación para marcar o ranurar los discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94	HN/94	0	130
ex 8466.91.00	-- Partes de las máquinas de amolar, pulir y rodar para la elaboración de discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94	HN/94	0	131
8466.93	-- Para máquinas de las partidas n°s 84.56 a 84.61							
ex 8466.93.00	-- Partes de las fresadoras de haces iónicos focalizadas para la producción o reparación de máscaras y retículos utilizados como modelos en los discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94	HN/94	0	132
ex 8466.93.00	-- Partes de las cortadoras por haz de láser para cortar las pistas de contacto en la producción de semiconductores mediante láser.	35	0	2010	UR/94	HN/94	0	133
ex 8466.93.00	-- Partes de las máquinas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones en la producción de discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94	HN/94	0	134
ex 8466.93.00	-- Partes de los aparatos para atacar en seco, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94	HN/94	0	135

SAC2002	Descripción de los Productos	Tipo Base	Tipo Consolidado	Implementación	Instrum. en el que se establece la concesión actual	DPN	Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT	Demás Derechos	Apénd. A - Sección 1	Apénd. A - Sección 2	Apénd. B
ex 8466.93.00	-- Partes de la máquinas para grabar en seco la traza sobre material semiconductor.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			136
8469	Máquinas de escribir, excepto las impresoras de la partida n° 84.71; máquinas para tratamiento o procesamiento de textos.										
8469.1	- Máquinas de escribir automáticas y máquinas para tratamiento o procesamiento de textos:										
8469.11.00	-- Máquinas para tratamiento o procesamiento de textos.	20	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0		2	
8470	Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de datos, con función de cálculo; máquinas de contabilidad, de franquear, expedir boletos (tiques) y máquinas similares, con dispositivo de cálculo incorporado; cajas registradoras.										
8470.10.00	- Calculadoras electrónicas que funcionen sin fuente de energía eléctrica exterior y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de datos, con función de cálculo.	35	0	2010	WT/Let/403	CAN	HN/94	0		3	
8470.2	- Las demás máquinas de calcular electrónicas:										
8470.21.00	-- Con dispositivo de impresión incorporado.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0		4	
8470.29.00	-- Las demás.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0		5	
8470.30.00	- Las demás máquinas de calcular.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0		6	
8470.40.00	- Máquinas de contabilidad.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0		7	
8470.50.00	- Cajas registradoras.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0		8	
8470.90.00	- Las demás.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0		9	

<u>SAC2002</u>	<u>Descripción de los Productos</u>	<u>Tipo Base</u>	<u>Tipo Consolidado</u>	<u>Implementación</u>	<u>Instrum. en el que se establece la concesión actual</u>	<u>DPN</u>	<u>Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT</u>	<u>Demás Cargas y Derechos</u>	<u>Apénd. A - Sección 1</u>	<u>Apénd. A - Sección 2</u>	<u>Apénd. B</u>
8471	Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte.										
8471.10.00	- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, analógicas o híbridas.	10	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	10		191
8471.30.00	- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador.	10	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	11		191
8471.4	- Las demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales:										
8471.41.00	- - Que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad central de proceso y, aunque estén combinadas, una unidad de entrada y una de salida	10	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	12		191, 203
8471.49.00	- - Las demás presentadas en forma de sistemas.	10	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	13		191, 201
8471.50.00	- Unidades de proceso digitales, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida.	10	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	14		194, 199
8471.60.00	- Unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma envoltura.	10	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	15		193, 195, 198, 200

SAC2002	Descripción de los Productos	Tipo Base	Tipo Consolidado	Implementación	Instrum. en el que se establece la concesión actual	DPN	Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT	Demás Cargas y Derechos	Apénd. A - Sección 1	Apénd. A - Sección 2	Apénd. B
8471.70.00	- Unidades de memoria.	10	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	16		196, 201
8471.80.00	- Las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos.	10	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	17		200
8471.90.00	- Los demás.	10	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	18		196, 202
8472	Las demás máquinas y aparatos de oficina (por ejemplo: copiadoras hectográficas, mimeógrafos, máquinas de imprimir direcciones, distribuidores automáticos de billetes de banco, máquinas de clasificar, contar o encartuchar monedas, sacapuntas, perforadoras, grapadoras).										
8472.90	- Los demás										
ex 8472.90.00	- Cajeros automáticos.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0	19		
8473	Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas n°s 84.69 a 84.72.										
8473.2	- Partes y accesorios de máquinas de la partida n° 84.70:										
8473.21.00	-- De máquinas de calcular electrónicas de las subpartidas 8470.10, 8470.21 u 8470.29.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0	20		193
8473.29.00	-- Los demás.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0	21		193
8473.30.00	- Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71.	10	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	22		193, 199
8473.50.00	- Partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con máquinas o aparatos de varias de las partidas 84.69 a 84.72.	35	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	23		193, 199

<u>SAC2002</u>	<u>Descripción de los Productos</u>	<u>Tipo Base</u>	<u>Tipo Consolidado</u>	<u>Implementación</u>	<u>Instrum. en el que se establece la concesión actual</u>	<u>Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT</u>	<u>Demás Cargas y Derechos</u>	<u>Apénd. A - Sección 1</u>	<u>Apénd. A - Sección 2</u>	<u>Apénd. B</u>
					<u>DPN</u>					
8477	Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.									
8477.10	- Máquinas de moldear por inyección									
ex 8477.10.00	- Equipos de encapsulación para el montaje de semiconductores.	35	0	2010	UR/94	HN/94	0		137	
8477.90	- Partes									
ex 8477.90.00	- Partes de los equipos de encapsulación.	35	0	2010	UR/94	HN/94	0		138	
8479	Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.									
8479.50	- Robots industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte									
ex 8479.50.00	- Máquinas automatizadas para el transporte, la manipulación y el almacenamiento de discos (obleas) semiconductores, cassetes de discos (obleas), cajas de discos (obleas) y demás material para dispositivos semiconductores	35	0	2010	UR/94	HN/94	0		139	
8479.8	- Las demás máquinas y aparatos:									
8479.89	- - Los demás									
ex 8479.89.00	Aparatos para el crecimiento y estiramiento de los lingotes semiconductores monocristalinos	35	0	2010	UR/94	HN/94	0		140	
ex 8479.89.00	Aparatos para la deposición física por pulverización en discos (obleas) semiconductores	35	0	2010	UR/94	HN/94	0		141	

SAC2002	Descripción de los Productos	Tipo Base	Tipo Consolidado	Implementación	Instrum. en el que se establece la concesión actual	DPN	Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT	Demás Cargas y Derechos	Apénd. A - Sección 1	Apénd. A - Sección 2	Apénd. B
ex 8479.89.00	Aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y los visualizadores de panel plano	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			142
ex 8479.89.00	Aparatos de fijación por matriz, soldadores automáticos de cintas y soldadores de hilos para el montaje de semiconductores	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			143
ex 8479.89.00	Equipos de encapsulación para el montaje de semiconductores	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			144
ex 8479.89.00	Máquinas de deposición epitaxial para los discos (obleas) semiconductores	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			145
ex 8479.89.00	Máquinas para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar los hilos de salida de los semiconductores	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			146
ex 8479.89.00	Aparatos de deposición física para la producción de semiconductores	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			147
ex 8479.89.00	Rotores para revestir con emulsiones fotográficas los discos (obleas) semiconductores	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			148
8479.90	- Partes										
ex 8479.90.00	Partes de los aparatos para la deposición física por pulverización en discos (obleas) semiconductores	20	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0			149
ex 8479.90.00	Partes de los aparatos de fijación por matriz, soldadores automáticos de cintas y soldadores de hilos para el montaje de semiconductores	20	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0			150
ex 8479.90.00	Partes de rotores para revestir con emulsiones fotográficas los discos (obleas) semiconductores	20	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0			151
ex 8479.90.00	Partes de los aparatos para el crecimiento y estramiento de los lingotes semiconductores monocristalinos	20	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0			152

<u>SAC2002</u>	<u>Descripción de los Productos</u>	<u>Tipo Base</u>	<u>Tipo Consolidado</u>	<u>Implementación</u>	<u>Instrum. en el que se establece la concesión actual</u>	<u>DPN</u>	<u>Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT</u>	<u>Demás Cargas y Derechos</u>	<u>Apénd. A - Apénd. A - Apénd. A - Apénd. A - Apénd. B</u>
								<u>Sección 1</u>	<u>Sección 2</u>
ex 8479.90.00	Partes de los aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y los visualizadores de panel plano	20	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	153
ex 8479.90.00	Partes de las máquinas automatizadas para el transporte, la manipulación y el almacenamiento de los discos (obleas) de semiconductores, las cassetes de discos (obleas), las cajas de discos (obleas) y demás material para dispositivos semiconductores	20	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	154
ex 8479.90.00	Partes de los equipos de encapsulación para el montaje de semiconductores	20	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	155
ex 8479.90.00	Partes de las máquinas de deposición epitaxial para los discos (obleas) semiconductores	20	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	156
ex 8479.90.00	Partes de las máquinas para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar los hilos de salida de los semiconductores	20	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	157
ex 8479.90.00	Partes de los aparatos de deposición física para la producción de semiconductores	20	0	2010	WT/Let/403	USA	HN/94	0	158
8480	Partes de los aparatos de deposición física para la producción de semiconductores								
8480.7	- Moldes para caucho o plástico:								
8480.71	-- Para moldeo por inyección o compresión								
ex 8480.71.00	-- Moldes por inyección o por compresión para la fabricación de dispositivos semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0	159

SAC2002	Descripción de los Productos	Tipo Base	Tipo Consolidado	Implementación	Instrum. en el que se establece la concesión actual	DPN	Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT	Demás Cargos Y Derechos	Apénd. A - Apénd. A - Apénd. A - Apénd. A - Apénd. B
								Sección 1	Sección 2
8504	Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).								
8504.40	- Convertidores estáticos								
ex 8504.40.00	- Convertidores estáticos destinados a máquinas automáticas para tratamiento de información y sus unidades, y aparatos de telecomunicación.	10	0	2010	WT/Let/403	CE12 -USA	HN/94	0	24
8504.50	- Las demás bobinas de reactancia (autoinducción)								
ex 8504.50.00	- Las demás bobinas de reactancia y de autoinducción para fuentes de alimentación de máquinas automáticas para tratamiento de información y sus unidades, y aparatos de telecomunicación.	10	0	2010	WT/Let/403	CE12	HN/94	0	25
8514	Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los de inducción o pérdidas dieléctricas; los demás aparatos industriales o de laboratorio para tratamiento térmico de materias por inducción o pérdidas dieléctricas.								
8514.10	- Hornos de resistencia (de calentamiento indirecto)								
ex 8514.10.00	- Hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0	160
8514.20	- Hornos de inducción o pérdidas dieléctricas								

<u>SAC2002</u>	<u>Descripción de los Productos</u>	<u>Tipo Base</u>	<u>Tipo Consolidado</u>	<u>Implementación</u>	<u>Instrum. en el que se establece la concesión actual</u>	<u>DPN</u>	<u>Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT</u>	<u>Demás Cargas y Derechos</u>	<u>Apénd. A - Sección 1</u>	<u>Apénd. A - Sección 2</u>	<u>Apénd. B</u>
ex 8514.20.00	- Hornos que trabajen por inducción o por pérdidas dieléctricas para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			161
8514.30	- Los demás hornos										
ex 8514.30.00	-- Hornos para el calentamiento rápido de discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			162
ex 8514.30.00	-- Hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			163
8514.90	- Partes										
ex 8514.90.00	Partes de aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas)	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			164
ex 8514.90.00	Partes de hornos de las partidas Nos 8514 10 a 8514 30	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			165
8517	Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de abonado de auricular inalámbrico, combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos.										
8517.1	- Teléfonos de abonado; videófonos:										
8517.11.00	-- Teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono.	8	0	2010	WT/Let/403		HN/94	0		26	
8517.19.00	-- Los demás.	8	0	2010	WT/Let/403		HN/94	0		27	